

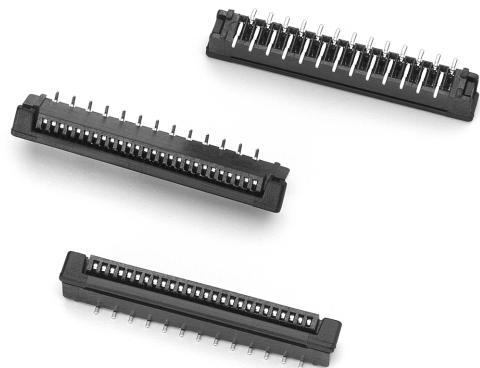
# 5580

## ZIF-Stecker - SMT - RM 0,50 mm - vertikaler Eingang

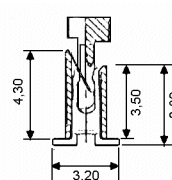
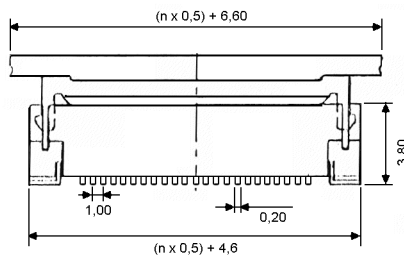
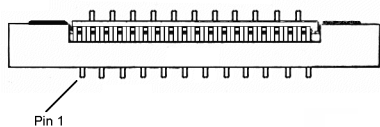
ZIF-Connector - SMT - Pitch 0,50mm - Vertical Entry

### Technische Daten / Technical Data:

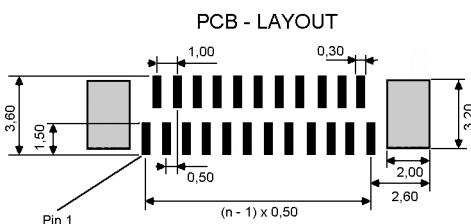
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0 <i>Thermoplastic, rated UL94V0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor Bronze</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Zinn über Nickel <i>tin plated over nickel</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	$> 10^8 \text{ Ohm}$
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	250 V <sub>AC</sub>
Nennspannung <i>Current Voltage</i>	50 V <sub>AC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	0,5 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-20°C...+85°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T <i>Reflow-Soldering, further informations in chapter T</i>



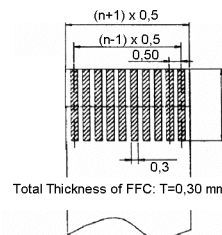
© W+P PRODUCTS



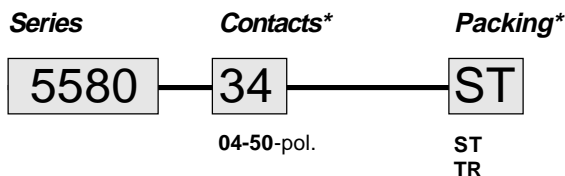
Recommended Flexible Flat Cable (FFC)



n = Anzahl Kontakte  
n = No. of Contacts



Total Thickness of FFC: T=0,30 mm



(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

### Lieferformen / Packing Options:

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes  
TR = Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX : +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL: sales@wpro.com  
INTERNET: www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):*

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

*Recommended Reflow-Soldering profile:*



T